

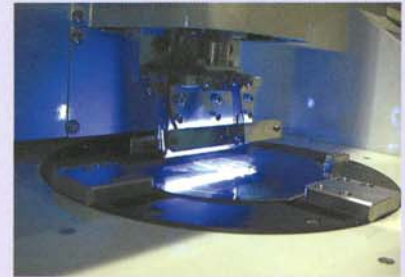
# 精密スクライブ後のウェハを全自動でチップ化！！



Photo:NVK-100

高剛性ブレーカー

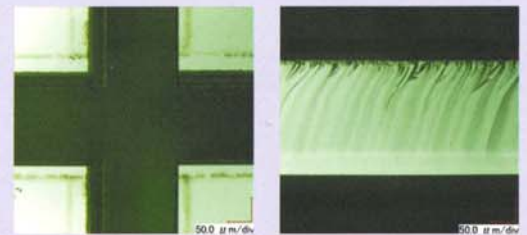
## NVK 100 series



ブレイクの様子

あらかじめチップ化のためにスクライブされた難削材ウェハ (SiC, GaN, サファイア, セラミックス, 水晶, 磁性材料等) を全自動高速でチップ化を行うことが可能なマシン。

1. 各種難削材ウェハ (SiC, GaN, サファイア, セラミックス, 水晶, 磁性材料等) のスクライブラインを画像処理で自動アライメントを行いブレイクします。さらに任意角度旋回し、Y方向のアライメント、ブレイクでチップ化します。
2. 操作は、タッチパネル方式で簡単！
3. 50種以上のブレイク条件を保存可能。品種毎の管理をすることが可能。
4. ロボットと組み合わせることで、カセットからカセットまでのロード・アンロードを含むワークセッティング・アライメント・X, Yブレイクを全て自動化する事が可能。



SiCウェハ切断後の写真

### 操作画面



自動設定



手動設定



カット調整

特長